

⑨日本国特許庁(JP)

⑩公開特許公報 (A)

⑪特許出願公開

昭54-146633

⑫Int. Cl.³
B 41 J 3/04識別記号 ⑬日本分類
103 K 0庁内整理番号
6662-2C⑭公開 昭和54年(1979)11月16日
発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑯インクジェット記録用ノズルヘッド

⑰特 願 昭53-54444

⑱出 願 昭53(1978)5月10日

⑲発 明 者 嶋田智

日立市幸町3丁目1番1号 株
式会社日立製作所日立研究所内
川上寛児日立市幸町3丁目1番1号 株
式会社日立製作所日立研究所内
松田泰昌日立市幸町3丁目1番1号 株
式会社日立製作所日立研究所内
高要泰作

⑳発 明 者 寒河江正次

日立市幸町3丁目1番1号 株
式会社日立製作所日立研究所内
土井香夫日立市幸町3丁目1番1号 株
式会社日立製作所日立研究所内
株式会社日立製作所東京都千代田区丸の内一丁目5
番1号

㉑代 理 人 弁理士 武頭次郎

最終頁に続く

明 細 書

①発明の名称 インクジェット記録用ノズルヘッド
②発明の趣意1. ノズル用の網を有する基板と、この基板に被
覆して前記網の細分ノズル穴を形成する覆板と
を備えたインクジェット記録用ノズルヘッドにお
いて、前記基板と覆板とは互いに密着結合が可能
な材質の組合せからなり、この両者は密着結合に
より一体化されていることを特徴とするインクジ
ェット記録用ノズルヘッド。2. 特許請求の範囲第1項において、前記基板と
前記覆板とは同等の熱膨張係数を有することを特
徴とするインクジェット記録用ノズルヘッド。3. 特許請求の範囲第1項において、前記基板の
材質は半導体であり、前記覆板の材質は樹脂膜カ
ラスであることを特徴とするインクジェット記録
用ノズルヘッド。4. 特許請求の範囲第1項において、前記基板の
材質は半導体であり、前記覆板の材質はセラミッ
クスであることを特徴とするインクジェット記録

用ノズルヘッド。

5. 特許請求の範囲第1項において、前記覆板は
2枚の基板の間に挟まれ、前記網は各基板の蓋板
側に形成されていることを特徴とするインクジエ
ット記録用ノズルヘッド。6. 特許請求の範囲第1項において、前記覆板は
2枚の基板の間に挟まれ、前記網は両基板の両面に
形成されていることを特徴とするインクジェット
記録用ノズルヘッド。7. 特許請求の範囲第1項において、前記覆板は
2枚の基板の間に挟まれ、前記網は両面を貫通し
て形成されていることを特徴とするインクジエ
ット記録用ノズルヘッド。

発明の詳細な説明

本発明は、インクをノズルから放射して記録用
紙等に所望の記録を行なうインクジェット記録装
置に用いられるノズルヘッドに係り、特にそのノ
ズルヘッドを構成する基板と覆板との組合せに関す
る。

第1図は既に提案されているオン・デマンド型

していないことが確認された。また、接合液は、両者を引きはがす際に両者の一部が溶融するほどに大きなるものであつた。このようにして静電接合が完了したら、基板 8 の、ポンプ室に相当する部分の表面に圧電振動子を接合することにより、ノズルヘッドが完成する。

基板として用いられるシリコンは、多結晶でも単結晶でもよいが、特に、単結晶を用い、表面に形成した SiO_2 をマスクとしてアルカリエッチング法によりノズル用の溝を形成すると、エッチング速度が結晶方位により著しく異なるため、シリコン基板の結晶面と溝方向を工夫することにより、均一な鋭い断面形状を有する寸法精度の高い溝を形成することができる。

また、基板として用いられる導電性ガラスは、シリコンとはほぼ同じ熱膨張係数を有しており、シリコン基板と静電接合する際に、高温にしても熱歪が少なく済む。

本実施例では、基板としてシリコンを、基板として導電性ガラスを用いたが、基板としてシリ

コン、タルマニウム等の半導体、基板としてセラミックスを用いることもでき、これら以外にも静電接合可能な基板及び基板の材質の組合せがあり、好ましいものを例示すると次表のとおりである。

基 板	接 合 液
鉄、ニッケル系低膨張合金 (例えばコバール、ファニー)	硼硅酸ガラス
鉄、銅、アルミニウム等の 金属	左の金属に近い熱膨張係数を有するソーダガラス

静電接合可能な材質の組合せは米国特許第3397278号明細書によれば、これ以外にも次のようなものがある。

材質の組合せ	電圧密度($\mu\text{A}/\text{mm}^2$)	時間(分)	温度($^{\circ}\text{C}$)
Si ~ 石英	10	2	500
Si ~ ソフトガラス	5	4	450
Si ~ サファイア	1	1	650
Ge ~ 硼酸ガラス	5	2	450
GeAs ~ ソフトガラス	25	3	450
Asシート ~ 硼酸ガラス	1	10	400
Pi フォイル ~ ソフトガラス	5	7	400
Be シート ~ ガラス	35	5	400
Ti シート ~ ガラス	25	5	400
Pa ~ ガラスセラミクス	200	5	400

ノズルヘッドの製造に用いる材質の組合せは、加工の容易さ、平面度上げの容易さ、最高許容速度、入手の容易さ、コストなどを考慮して選ばれる。

第5図及び第6図は本発明の他の実施例を示す。この実施例は、2枚の基板 7A、7B の間に1枚の基板 8 をサンドウイッチ状に挟んで、互いに静電接合したものである。両基板 7A、7B の表面には、第2図及び第3図に示したものと同等の溝がそれぞれ形成されている。このようにして、両基板 8 の厚みを略して2列に並ぶノズル穴 11A、11B を形成でき、高膨張マルチノズルが得られる。圧電振動子 9A、9B は、両基板 7A、7B の、ポンプ室 12A、12B に相当する部分の表面に接合されている。基板 7A、7B と基板 8 の材質は前記実施例と同じである。その他の部分は第2図及び第3図に示すものと同様である。同一部分には同一符号を付して説明を省略する。

第7図は、この実施例に係るノズルヘッドを製造する工程を示す。

造する際の基板 7A、7B と基板 8 との静電接合を示す。基板 7A、7B の外表面には + 電極 15A、15B を形成させ、基板 8 には基板 7A、7B の表面から突出する部分 8a を設け、そこに - 電極 16 を形成させる。その他、接合面の仕上げ、温度、電圧、時間等は第4図に示した実施例の場合と同様であるので、同一部分には同一符号を付して説明を省略する。

この実施例では、圧電振動子が基板のポンプ室に相当する部分の外表面に接合されており、この圧電振動子を接合する部分の基板の厚さは、エッチングによって、薄くしかも精度よく仕上げることで、圧電振動子に加える励振電圧が小さくても効果のよいポンプ作用を得ることができる。

第8図は、本発明のさらに他の実施例を、その製造方法と共に示す。この実施例は、2枚の基板 8A、8B の間に1枚の基板 7 をサンドウイッチ状に挟んで、互いに静電接合したものである。基板 7 には、両面に第2図及び第3図に示したものと

と同様に溝が形成されている。このようにしても2列のノズル穴13A, 13Bが形成できる。基板7の両面に形成する場合は、両面マスクアライナーを用いれば、フォトリソニング法により約10μm以下の位置ずれで形成することができ、この実施例のものは第6図及び第6図に示す実施例のものに比べて、上下のノズル穴13A, 13Bの位置ずれ精度が高い点で優れている。その他の構成及び製造方法は第4図に示す実施例と同様であるので、同一部分には同一符号を付して説明を省略する。

第9図は、本発明のさらに他の実施例を、その製造方法と共に示す。2枚の基板8A, 8Bの間に1枚の基板7を挟んで互いに静電接合した点は第8図に示すものと同様であるが、この実施例では、基板7の溝が基板7を貫通して形成されており、ノズル穴13は1列である。このようなノズルヘッドを製造するには、まず、第10図に示すように、基板7にそれを貫通する所定形状の穴をエッチング又は打抜き加工等により形成し、この溝

両性の保護被膜19を設けたものである。この保護被膜19の材質は例えばSiO₂等が好ましく、スパッタリングやCVD法等により基板7に被覆させることができる。保護被膜19を設ける理由は、基板としてシリコンのようアルカリに弱いものを用いると、インクが弱アルカリ性であるため、インクによつて基板が侵食されるかそれがあるからである。また、シリコン等の表面はインクをはじく性質があるが、SiO₂等の保護被膜を設けるとインクの濡れ性がよくなる。

第18図は本発明のさらに他の実施例を示す。この実施例は、基板7と基板8の両方に耐食性保護被膜19A, 19Bを設けたものである。

なお、上記第12図及び第13図に示す各実施例の説明において、上記以外の構成は第4図に示す実施例と同様であるので、同一部分には同一符号を付して説明を省略する。

以上説明したように、本発明によれば、ノズル溝の溝を有する基板とこれに被る基板とが静電接合により一体化されているので、従来のように

特開第54-146633号

基板7の両面に基板8A, 8Bを重ね合わせて静電接合した点、第10図のX-X線に沿つて切断すればよい。その他の構成及び製造方法は第4図に示す実施例と同様であるので、同一部分には同一符号を付して説明を省略する。

第11図は、本発明のさらに他の実施例を、その製造方法と共に示す。この実施例は、基板7とこの基板7と同じ材質の基板本体8bとの間に溝い接合板8cを挟んで互いに静電接合したもので、基板本体8bと接合板8cとで基板8が形成されている。その他の構成は第4図に示す実施例と同様であり、また静電接合の際の電圧のかけ方は第7図の場合と同様であるので、同一部分には同一符号を付して説明を省略する。なお、この実施例において、接合板8cは予め基板本体8bに蒸着法やスパッタリング法で被覆させることにより形成してもよい。その場合は基板本体8bは基板7と別の材質で形成することができる。

第12図は、本発明のさらに他の実施例を示す。この実施例は、基板7のインクが触れる部分に溝

ノズル穴内に接着剤等が侵入することがなく、ノズル穴の寸法精度を高くすることができ、且つばらつきを小さくすることができる。したがって、微細なインクジェットを正確に噴射して印刷を施すことができる。

図面の簡単な説明

第1図はオン・デマンド型のインクジェット印刷装置の一側を示す概略構成図、第2図及び第3図は第1図の装置に用いられるノズルヘッドの正面図及び側面図、第4図は本発明の一実施例に係るノズルヘッドを製造方法と共に示す正面図、第5図及び第6図は本発明の他の実施例に係るノズルヘッドを示す正面図及び側面図、第7図は第4図のノズルヘッドを製造するのに用いられる基板の水平断面図、第8図ないし第13図はそれぞれ本発明のさらに他の実施例に係るノズルヘッドを示す正面図である。

7A, 7B...基板、8, 8A, 8B...
13, 13A, 13B...ノズル穴

代理人 丹澤士 武 源 次



特開 昭54-146533(5)

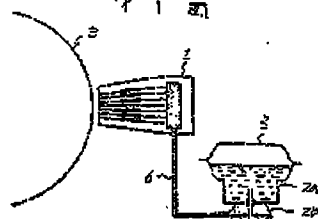


図 2

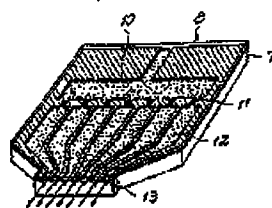


図 3

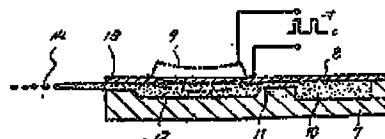


図 4

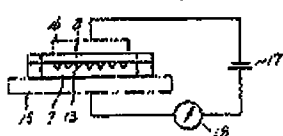


図 5

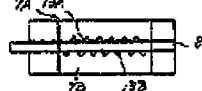


図 6

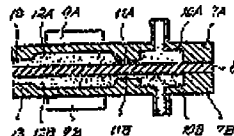


図 7

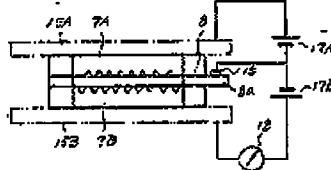


図 8

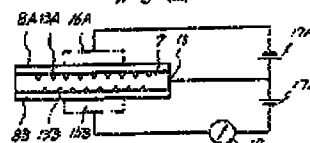
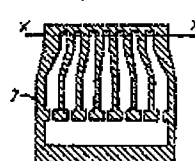


図 9



図 10



特開 1054-14653 号

第 1 頁の続き

②発明者 西原元久

日立市幸町 3 丁目 1 番 1 号 株

式会社日立製作所日立研究所内

同

山田剛裕

日立市幸町 3 丁目 1 番 1 号 株

式会社日立製作所日立研究所内

図 11

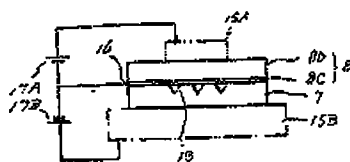


図 12

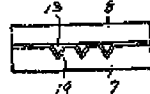


図 13

